**证券代码：605358**  **证券简称：立昂微**

**杭州立昂微电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-005

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ●特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □新闻发布会  □现场参观 □电话会议  □其他 |
| 参与单位名称及时间 | 2025年8月13日15：00广发证券、博时基金等2人  2025年8月29日15：00华夏基金1人 |
| 地点 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 |
| 投资者关系活动记录 | 公司围绕已披露的半年度经营情况进行了说明，投资者交流的问题回复内容如下：  1.公司外延片的产能利用率高，是否有涨价？  答：公司6-8英寸外延片产品自年初以来订单饱满，产能利用率保持在较高水平；12寸外延片产品同样订单饱满，出货量同比、环比均有大幅增长。在此情况下，公司优先选择高价值量产品订单，公司因出货结构的变化单片价格有所提高。  2.公司是否有应用于AI服务器的产品？  答：公司重掺低阻外延片和750v FRD芯片可终端应用于AI服务器的不间断电源。  3.公司未来业务重点放在哪一板块？  答：半导体硅片业务板块将依托公司重掺技术优势，重点开发8-12英寸重掺外延片，推进12英寸轻掺硅片产能爬坡；功率器件芯片业务板块进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户，提高车规产品、FRD产品等高附加值产品的比重；化合物半导体射频和光电芯片业务聚焦推动海宁生产基地产量提升，重点发展VCSEL芯片工艺、pHEMT、BiHEMT芯片工艺及6英寸碳化硅基氮化镓产品等高附加值产品。 |
| 资料清单（如有） | 无 |